



## 工業技術研究院 智慧機械與智慧製造等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含智慧機械與智慧製造等相關專利 16 案 39 件(以下簡稱「讓與標的」)。「讓與標的」共分為六個類別：(一)智慧機械技術(4 案 9 件)、(二)製造設備技術(3 案 13 件)、(三)智慧自動化技術(5 案 10 件)、(四)放電加工技術(1 案 2 件)、(五)線切割放電加工技術(2 案 2 件) 及(六)工具機技術(1 案 3 件)。部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果。詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網 (<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>)、及工研院研發成果公告網站 (<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>)。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國(下同)108年5月7日15時於工研院中興院區51館108室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於108年5月3日中午12時整(含)前發送電子郵件(請於電子郵件主旨上註明「智慧機械與智慧製造等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。)予工研院技術移轉與法律中心(以下簡稱「技轉法律中心」)聯絡人(請詳十二、聯絡方式)進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於108年5月6日下午5時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日108年5月16日下午5時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：



1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「智慧機械與智慧製造等相關專利讓與案投標」並標示出欲投標的技術類別（共六個類別），於截標日 108 年 5 月 16 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：  
31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室  
工研院技轉法律中心 林小姐 收
2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

## 六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

## 七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

## 八、決標方法：

1. 開標日為 108 年 5 月 17 日（開標時間及地點另行通知投標廠商）。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。



5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

## 九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」





有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、主管機關及立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：
  - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
  - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
  - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
  - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。
13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：
  - (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能



達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15. 得標廠商應使所有「後手」遵守九、契約事項第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

#### 十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

#### 十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

#### 十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：(03) 591-6636，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：讓與標的清單

技術分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號	專利起期	專利迄期	專利種類	科專/自有	契約運用
(一) 智慧機械 技術 (4案 9件)	1	1	P53960087TW	復健機器人之教導式學習 控制方法以及該復健機器 人	獲 證	台灣	I357586	2012 0201	2027 1129	發明	科專	曾非專屬授權
		2	P53960087US		獲 證	美國	7,812,560	2010 1012	2029 0402	發明	科專	曾非專屬授權
	2	3	P53970050TW	累積式速度限制值的估測 方法及利用累積式速度限 制值估測方法的控制插值 前加減速運動之方法	獲 證	台灣	I375140	2012 1021	2028 1012	發明	科專	曾非專屬授權
		4	P53970050US		獲 證	美國	8,078,295	2011 1213	2030 0509	發明	科專	曾非專屬授權
	3	5	P53980073TW	聯結多系統達成多軸同步 插值裝置與方法	獲 證	台灣	I402641	2013 0721	2029 1203	發明	科專	曾非專屬授權
		6	P53980073CN		獲 證	中國	ZL200910260988.4	2012 1010	2029 1217	發明	科專	曾非專屬授權
		7	P53980073US		獲 證	美國	8,364,288	2013 0129	2031 0225	發明	科專	曾非專屬授權
	4	8	P53980117TW	控制參數調整裝置及其控 制參數調整方法	獲 證	台灣	I421717	2014 0101	2030 0412	發明	科專	曾非專屬授權
		9	P53980117US		獲 證	美國	8,364,305	2013 0129	2031 0511	發明	科專	曾非專屬授權
(二) 製造 設備 技術 (3案 13件)	5	10	P53010030TW	旋轉式流量控制裝置	獲 證	台灣	I487851	2015 0611	2032 0927	發明	科專	
		11	P53010030CN		獲 證	中國	ZL201210419834.7	2016 0511	2032 1028	發明	科專	
		12	P53010030JP		獲 證	日本	5406359	2013 1108	2032 1126	發明	科專	
	6	13	P53970116TW	剛性自動補償液靜壓平面 軸承裝置與方法	獲 證	台灣	I391576	2013 0401	2029 0512	發明	科專	曾非專屬授權
		14	P53970116US		獲 證	美國	8,333,512	2012 1218	2031 0418	發明	科專	曾非專屬授權
		15	P53970116JP		獲 證	日本	5189118	2013 0201	2030 0224	發明	科專	曾非專屬授權
		16	P53970116DE		獲 證	德國	EP2251556	2013 0703	2030 0511	發明	科專	曾非專屬授權
		17	P53970116IT		獲 證	義大利	EP2251556	2013 0703	2030 0511	發明	科專	
	7	18	P53990052TW	自動補償液靜壓軸頸軸承	獲 證	台灣	I407023	2013 0901	2030 1202	發明	科專	曾非專屬授權
		19	P53990052CN		獲 證	中國	ZL201010601234.3	2015 1028	2030 1221	發明	科專	
		20	P53990052US		獲 證	美國	8,485,729	2013 0716	2031 1030	發明	科專	曾非專屬授權
		21	P53990052JP		獲 證	日本	5509148	2014 0328	2031 0427	發明	科專	
		22	P53990052DE		獲 證	德國	DE102011050021	2015 0108	2031 0428	發明	科專	
(三) 智慧 自動 化技 術(5案 10件)	8	23	P04930098TW	細胞分殖裝置	獲 證	台灣	I270362	2007 0111	2024 1227	發明	科專	曾專屬授權
		24	P04930098US		獲 證	美國	7,727,760	2010 0601	2028 1204	發明	科專	曾專屬授權
	9	25	P53020046TW	智慧型烤箱裝置及其控制 方法	獲 證	台灣	I499398	2015 0911	2033 1003	發明	自有	
		26	P53020046CN		獲 證	中國	ZL201310566318.1	2017 0531	2033 1113	發明	自有	



技術分類	案次	件次	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	專利證號	專利起期	專利迄期	專利種類	科專/自有	契約運用
(三) 智慧 自動 化技 術 (5案 10件)	10	27	P53950063TW	用於細胞組織的擷取裝置 與擷取方法	獲證	台灣	I327165	2010 0711	2026 1228	發明	科專	曾專屬授權
		28	P53960088DE	變溫容器	獲證	德國	EP2070451	2015 0916	2028 1112	發明	科專	
	11	29	P53960088IT		獲證	義大利	EP2070451	2015 0916	2028 1112	發明	科專	
		12	30	P53990042TW	數位扭力工具校正方法、 驗證方法及校正系統	獲證	台灣	I429890	2014 0311	2030 1130	發明	科專
	31		P53990042CN	獲證		中國	ZL201010593403.3	2014 0702	2030 1216	發明	科專	
	32		P53990042US	獲證		美國	8,738,329	2014 0527	2032 1003	發明	科專	
(四) 放電 加工 技術 (1案 2件)	13	33	P04930089TW	3D 創成放電加工方法與程 式產生裝置	獲證	台灣	I277846	2007 0401	2024 1222	發明	科專	曾非專屬授權
		34	P04930089US	3D 創成放電加工方法與程 式產生裝置	獲證	美國	7,301,116	2007 1127	2025 0307	發明	科專	曾非專屬授權
(五) 線切 割放 電加 工技 術 (2案 2件)	14	35	P53020067TW	張力控制裝置及其方法	獲證	台灣	I519368	2016 0201	2033 1126	發明	科專	
	15	36	P53950105TW	線切割放電加工模組	獲證	台灣	I310712	2009 0611	2027 0401	發明	科專	
(六) 工具 機技 術 (1案 3件)	16	37	P53010041TW	液靜壓工作裝置	獲證	台灣	I516336	2016 0111	2032 1022	發明	科專	
		38	P53010041CN		獲證	中國	ZL201210475267.7	2015 1028	2032 1120	發明	科專	
		39	P53010041US		獲證	美國	8,931,956	2015 0113	2033 0227	發明	科專	曾非專屬授權

(本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。)